

# 半導体産業新聞 広告特集スケジュール

(2010年4月～2011年3月)

掲載号	特集タイトル	会場配布など	申込締切	原稿締切	特 集 内 容
10年4月7日号	ホトマスクジャパン2010特集	ホトマスクジャパン	2010 3/26	3/30	NGL成否のカギを握るフォトマスクの最新技術を追う！！
4月14日号	ファインテック・ジャパン2010特集 ライティングジャパン2010特集	ファインテック・ジャパン 次世代照明技術展	4/2	4/6	2010年度のFPD設備投資とFPDデバイスの生産・技術動向をまとめる。 LEDや有機ELなどの照明デバイスに関する展示会関連特集。
5月12日号	第13回組込みシステム開発技術展 (ESEC) 特集 FPGA/PLD特集 熱対策・ノイズ対策総合特集	ESEC	4/28	4/30	組込みMPU、EDA、IP、開発ツールなどの最新動向を紹介。 本格的な量産に適用され始めたFPGA/PLD技術の特集。 熱・ノイズ対策の技術と最新ソリューションを特集。
5月26日号	クリーンルーム・ミニエン化技術特集 エレクトロニクス材料の再資源化/有価物化特集		5/14	5/18	省エネ化が必須であるクリーンルーム事情と施工各社の動向。 レアメタル等を資源として活用する再資源化・有価物化を追う。
6月2日号	JPCA Show 2010特集	JPCA Show 2010	5/21	5/25	FPD、ビルドアップ基板、半導体用パッケージ基板などの最新市場。 JPCAと、半導体産業新聞の共催展「ラージエレクトロニクス」関連特集。
	ラージエレクトロニクスショー2010特集 平坦化技術特集 (CMP装置・材料特集)	ラージエレクトロニクスショー	5/6	5/17	CMPプロセスを中心とした平坦化技術動向。 ラージエレクトロニクスショーの開催を記念して特別付録の小冊子を作成。
	別冊付録「ラージエレ/JPCA Show 2010 全冊特集」		6/4	6/8	商社から見たサプライヤー、サプライヤーから見た商社。
6月16日号	半導体商社特集 (春季編)		6/4	6/8	生産性、歩留まり、装置の稼働率を向上させるMESやEESなどを特集。 半導体産業でも多用される直線運動案内・エンコーダを特集。
6月23日号	半導体工場の生産情報管理システム特集 直線運動案内・エンコーダ特集		6/11	6/15	太陽電池メーカー、製造装置、関連部材、検査測定機器などを紹介。 環境とエネルギーに関わる最新の製品・技術・サービス・情報などを紹介。 エコロジカルなIGBTやMOSFET等のパワーデバイス用製造装置を特集。
6月30日号	PVJapan 2010特集 新エネルギー・次世代電池総合特集 パワーデバイス用製造装置特集 (夏季編)	PVJapan 2010 新エネルギー世界展	6/18	6/22	半導体用超高純度ガス業界とその周辺をレポート。 瞬低・停電でのリスク対策と、瞬低補償装置や雷保護システムなどを紹介。 物流各社の戦略と動向を追う。中国での物流や製造装置の輸送も紹介。
7月7日号	半導体用ガスと関連装置・材料特集 電子デバイス工場の瞬低・停電・落雷リスク対策特集 エレクトロニクス物流特集		6/25	6/29	LED・化合物半導体特集 / 暑中見舞名刺広告企画 クリーンルーム用機器・部材特集 半導体・太陽電池産業で活躍するカーボン部材特集
7月21日号	LED・化合物半導体特集 / 暑中見舞名刺広告企画 クリーンルーム用機器・部材特集 半導体・太陽電池産業で活躍するカーボン部材特集		7/9	7/13	LED化合物デバイスの最新の技術、市場動向/恒例の「暑中見舞い広告」欄も。 モノづくり環境の清浄化に必要なクリーンルーム用機器・部材を紹介。 半導体・液晶、太陽電池等のハイテク分野で不可欠なカーボン部材を特集。
7月28日号	マイクロマシン/MEMS技術特集 熱対策技術特集	マイクロマシン/MEMS展	7/16	7/20	加速度センサーなど、MEMSのデバイスやプロセス、装置の最新動向を特集。 製品・システムをはじめ部品・材料・素材・ソフトウェアの最先端を紹介。
9月1日号	2010分析展特集 VACUUM2010 真空展特集 半導体・太陽電池製造装置用シール材特集	2010分析展 VACUUM2010	8/20	8/24	2010分析展の関連企画。展示会のみどころや、最新ソリューションを紹介。 重要度の高まる真空機器・ポンプ産業の市場動向と最新技術を特集。 シール材 (Oリング、パッキンなど) に焦点を当て、最新動向を特集。
9月8日号	カスタマー満足度調査・10BEST特集		8/27	8/31	10BESTは、VLSIリサーチ社が毎年行うカスタマー満足度調査との協賛企画。 高密度実装時代の3次元ICパッケージング、アッセンブリー技術を追う。 注目が集まる高輝度LED向けシリコン実装・封止材および各社の技術を紹介。
9月29日号	パッケージング技術特集 LED組立て・封止材特集	LED ジャパン2010	9/17	9/21	微細化で更に重要度を増す洗浄工程。半導体洗浄に関する総合特集。 半導体メーカーの環境・省エネ対策と、PF <sub>6</sub> 排ガス除害装置の各社動向。
10月13日号	半導体洗浄技術特集 環境保全・省エネ化特集	総合洗浄展 土壌・地下水環境展	10/1	10/5	45nm以降のリソグラフィ装置の動向およびフォトレジストの動向を追う。
10月27日号	リソグラフィ/フォトレジスト技術特集		10/15	10/19	FPDの製造装置、部品・材料、モジュールから応用製品までの動向。 拡大を続けるCCD/CMOS、イメージセンサーデバイス、バックグラウンドの最新動向。
11月10日号	FPD International 2010特集 CCD/CMOSイメージセンサー/バックグラウンド技術特集	FPD International 2010	10/29	11/2	検査、分析、加工、製造と各局面における最新の受託サービス動向。 65~45nmノードのキープロセスであるCuめっきプロセス技術の最新動向。 今後も成長が見込まれるディスペンス業界の動向を取材。 めっき装置、めっき液、めっき用レジストなどの装置・部材メーカー動向。
11月17日号	半導体/太陽電池分野のアウトソーシング特集 Cuめっき配線技術特集 半導体ディスペンス特集 TSVプロセス技術特集		11/5	11/9	半導体産業最大の展示会「セミコン・ジャパン」の関連企画。 組込みシステム技術に特化した世界最大級のイベントに関連した特集。 半導体商社の今を俯瞰し、上場および非上場企業の業績を一覧表にする。 GaAs、InPなどからGa <sub>0.5</sub> Si <sub>0.5</sub> 基板やMOCVD装置や化合物材料などを紹介。 シリコンウエハーの市場動向とウエハーメーカーの動向を追う。
12月1日号	セミコン・ジャパン2010総合特集 組込み総合技術展特集	セミコン・ジャパン2010 Embedded Technology 2010	11/18	11/22	電子デバイス業界の1年を予想する新春号 / 新春名刺広告欄を設ける。
12月8日号	半導体商社特集 (秋季編)		11/26	11/30	進化する高密度実装技術の最新動向を取材。 「第2回 カーエレJAPAN」の関連企画。 エコロジカルなIGBTやMOSFET等のパワーデバイス用製造装置を特集。 半導体産業に必要な不可欠なフッ素材料。様々なフッ素材料を紹介する。
12月15日号	LED・化合物半導体ウエハーと関連装置・材料特集 シリコンウエハーと関連装置・機器特集		12/3	12/7	EDA技術・ASIC、FPGA/PLDをはじめとする先進のデバイス技術などの紹介。 超純水製造装置メーカーや計測機器等の最新技術、各社動向を紹介。 ガス漏洩・火災対策や、薬液漏洩対策などの安全・災害対策特集。 「nano tech 2011」の開催を記念して、特別付録の小冊子を作成。
11年1月5日号	2011年新春特集 / 新春名刺広告企画		12/10	12/15	太陽電池関連企画。セルメーカーや、部材・装置メーカーの最新動向。 燃料電池の研究・開発・製造に関わる展示会の関連特集。 リチウムイオンなどの二次電池に関する専門展特集。 DRAM、フラッシュメモリーなどのマーケット動向、プロセス技術動向。
1月19日号	ネブコンワールドジャパン2011総合特集 カーエレJAPAN2011特集 パワーデバイス用製造装置特集 (冬季編) 半導体産業を支えるフッ素材料特集	半導体パッケージング技術展 国際カーエレクトロニクス技術展	2011 1/7	1/11	先端テスト技術や各種検査測定技術の動向および市場動向。 半導体産業の調査、分析、研究を担うリサーチカンパニーを総合的に紹介。
1月26日号	EDS Fair 2011特集	EDS Fair 2011	1/14	1/18	
2月16日号	半導体・液晶用超純水製造装置特集 電子デバイス工場の安全・災害対策特集 別冊付録「nano tech 2011 全冊特集」	nano tech 2011	2/4	2/8	
3月2日号	PV EXPO 2011特集 FC EXPO 2011特集 第2回 国際二次電池展特集 メモリー総合特集	国際太陽電池展 国際水素・燃料電池展	2/18	2/22	
3月9日号	半導体テスト/検査・測定技術特集 半導体リサーチ特集		2/25	3/1	

※特集スケジュールは、内容が変更になる場合がございます。ご了承下さい。

2010年3月10日現在

株式会社 産業タイムズ社 広告部

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル3階

TEL 03-5835-5893(直)

www.semicon-news.co.jp

FAX 03-5835-5493

ad@sangyo-times.co.jp